

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2003 年 4 月 10 日 (10.04.2003)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 03/030602 A1

(51) 国際特許分類: H05K 3/46, H01L 23/12

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/10172

(22) 国際出願日: 2002 年 9 月 30 日 (30.09.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2001-304651 2001 年 9 月 28 日 (28.09.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 凸版印刷株式会社 (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 塚本 健人 (TSUKAMOTO, Takehito) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP). 松澤 宏 (MATSUZAWA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP). 秋本 聡 (AKIMOTO, Satoshi) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番

1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP). 前原 正孝 (MAEHARA, Masataka) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP). 末本 匠 (SUEMOTO, Takumi) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP). 大出 雅之 (ODE, Masayuki) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP). 榊 祐一 (SAKAKI, Yuichi) [JP/JP]; 〒110-0016 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CA, CN, JP, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FI, FR, GB, SE).

添付公開書類:

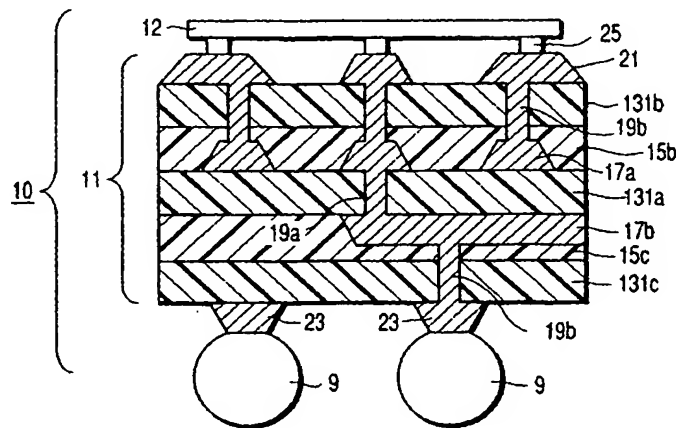
— 国際調査報告書

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MULTI-LAYERED CIRCUIT WIRING PLATE, IC PACKAGE, AND PRODUCTION METHOD OF MULTI-LAYERED CIRCUIT WIRING PLATE

(54) 発明の名称: 多層回路配線板、ICパッケージ、及び多層回路配線板の製造方法



(57) Abstract: A multi-layered circuit wiring plate includes a plurality of films (131a, 131b, 131c) stacked on one another. Wiring patterns (17a, 17b, 21, 23) are formed on at least one of the surfaces of each of the films (131a, 131b, 131c). The wiring patterns (17a, 17b, 21, 23) formed on the surfaces of the adjacent films (131a, 131b, 131c) are electrically connected via a via contact layer (19a, 19b) formed on one of the films (131a, 131b, 131c).

[続葉有]